## 海通证券股份有限公司 关于上海硅产业集团股份有限公司 2020 年半年度持续督导跟踪报告

根据《证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规的规定,海通证券股份有限公司(以下简称"海通证券"或"保荐机构")作为上海硅产业集团股份有限公司(以下简称"沪硅产业"、"公司"或"发行人")持续督导的保荐机构,负责沪硅产业上市后的持续督导工作,并出具本半年度持续督导跟踪报告。

#### 一、持续督导工作情况

序号	项目	持续督导工作情况	
/, ,	,	***************************************	
1 1		保荐机构已建立健全并有效执	
	1, 7, 5, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,		
		的具体情况制定了相应的工作	
		计划 (2.#.lp.16-21-10-21-16-18-21-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18	
2		保荐机构已与公司签署了保荐	
	根据中国证监会相关规定,在持续督导工作开始前,		
	与上市公司或相关当事人签署持续督导协议,明确双		
	方在持续督导期间的权利义务,并报上海证券交易所		
	备案	年,未发生对协议内容做出修改	
		或终止协议的情况	
3	通过日常沟通、定期回访、现场检查、尽职调查等方式 式开展持续督导工作	2020年上半年,保荐机构通过日	
		常沟通、不定期回访等方式,对	
		公司开展持续督导工作	
	持续督导期间,按照有关规定对上市公司违法违规事	2020年上半年,公司未发生需公	
4	项公开发表声明的,应于披露前向上海证券交易所报	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	
	告,经上海证券交易所审核后在指定媒体上公告	开发表声明的违法违规事项	
	持续督导期间,上市公司或相关当事人出现违法违规、		
	违背承诺等事项的,应自发现或应当发现之日起五个	2020年上半年,公司及相关当事	
	工作日内向上海证券交易所报告,报告内容包括上市	人未出现需报告的违法违规、违	
	公司或相关当事人出现违法违规、违背承诺等事项的	背承诺等事项	
	具体情况,保荐机构采取的督导措施等		
6	督导上市公司及其董事、监事、高级管理人员遵守法	保荐机构持续督促、指导公司及	
	律、法规、部门规章和上海证券交易所发布的业务规	其董事、监事、高级管理人员,	
	则及其他规范性文件,并切实履行其所做出的各项承		
		监事、高级管理人员能够遵守相	
	I		

		关法律法规的要求,并切实履行 其所做出的各项承诺
7	督导上市公司建立健全并有效执行公司治理制度,包 括但不限于股东大会、董事会、监事会议事规则以及	
8	督导上市公司建立健全并有效执行内控制度,包括但不限于财务管理制度、会计核算制度和内部审计制度,以及募集资金使用、关联交易、对外担保、对外投资、衍生品交易、对子公司的控制等重大经营决策的程序与规则等	核查了公司内控制度建立与执行情况,公司内控制度符合相关法规要求,2020年上半年,公司有效执行了相关内控制度
9	督导上市公司建立健全并有效执行信息披露制度,审阅信息披露文件及其他相关文件,并有充分理由确信 上市公司向上海证券交易所提交的文件不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏	保荐机构督促公司严格执行信息披露制度,审阅信息披露文件及其他相关文件,详见"二、保荐机构对公司信息披露审阅的情况"
10	对上市公司的信息披露文件及向中国证监会、上海证券交易所提交的其他文件进行事前审阅,对存在问题的信息披露文件应及时督促上市公司予以更正或补充,上市公司不予更正或补充的,应及时向上海证券交易所报告	详见"二、保荐机构对公司信息 披露审阅的情况"
11	对上市公司的信息披露文件未进行事前审阅的,应在 上市公司履行信息披露义务后五个交易日内,完成对 有关文件的审阅工作,对存在问题的信息披露文件应 及时督促上市公司更正或补充,上市公司不予更正或 补充的,应及时向上海证券交易所报告	详见"二、保荐机构对公司信息 披露审阅的情况"
12	关注上市公司或其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员受到中国证监会行政处罚、上海证券交易所纪律处分或者被上海证券交易所出具监管关注函的情况,并督促其完善内部控制制度,采取措施予以纠正	2020年上半年,公司或其控股股东、实际控制人、董事、监事、 高级管理人员未受到中国证监 会行政处罚、上海证券交易所纪 律处分或者被上海证券交易所 出具监管关注函的情况
13	关注上市公司及控股股东、实际控制人等履行承诺的 情况,上市公司及控股股东、实际控制人等未履行承 诺事项的,保荐人应及时向上海证券交易所报告	
14	关注公共传媒关于上市公司的报道,及时针对市场传闻进行核查。经核查后发现上市公司存在应披露未披露的重大事项或与披露的信息与事实不符的,保荐人应及时督促上市公司如实披露或予以澄清;上市公司不予披露或澄清的,应及时向上海证券交易所报告	
15	在持续督导期间发现以下情形之一的,保荐人应督促 上市公司做出说明并限期改正,同时向上海证券交易 所报告: (一)上市公司涉嫌违反《上市规则》等上	2020年上半年,公司及相关主体 未出现该等事项

海证券交易所相关业务规则; (二)证券服务机构及 其签名人员出具的专业意见可能存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏等违法违规情形或其他不当情形; (三)上市公司出现《保荐办法》第六十七条、第六 十八条规定的情形; (四)上市公司不配合保荐人持 续督导工作; (五)上海证券交易所或保荐人认为需 要报告的其他情形 制定对上市公司的现场检查工作计划,明确现场检查 工作要求,确保现场检查工作质量。上市公司出现以 下情形之一的,保荐人应自知道或应当知道之日起十 五日内或上海证券交易所要求的期限内,对上市公司 进行专项现场检查: (一) 控股股东、实际控制人或 2020年上半年度,公司未出现该 16 其他关联方非经营性占用上市公司资金; (二)违规 等事项 为他人提供担保; (三)违规使用募集资金; (四) 违规进行证券投资、套期保值业务等; (五)关联交 易显失公允或未履行审批程序和信息披露义务;(六) 业绩出现亏损或营业利润比上年同期下降 50%以上; (七)上海证券交易所要求的其他情形 保荐机构对公司募集资金的专 户存储、募集资金的使用以及投 持续关注上市公司建立募集资金专户存储制度与执行 资项目的实施等承诺事项进行 17 情况、募集资金使用情况、投资项目的实施等承诺事 了持续关注, 督导公司执行募集 资金专户存储制度及募集资金 监管协议

#### 二、保荐机构对公司信息披露审阅的情况

海通证券持续督导人员对公司 2020 年上半年的信息披露文件进行了事先或事后审阅,包括股东大会会议决议及公告、董事会会议决议及公告、监事会会议决议及公告、监事会会议决议及公告、募集资金使用和管理的相关报告和其他临时公告等文件,对信息披露文件的内容及格式、履行的相关程序进行了检查。

经核查,保荐机构认为,沪硅产业严格按照证券监督部门的相关规定进行信息披露,依法公开对外发布各类定期报告或临时报告,确保各项重大信息的披露真实、准确、完整、及时,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

#### 三、保荐机构和保荐代表人发现的问题及整改情况

无。

#### 四、重大风险事项

公司目前面临的风险因素主要如下:

#### (一) 尚未盈利的风险

2020年上半年,公司的营业收入为85,427.37万元,公司归属于母公司股东的净利润、归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润分别为-8,259.42万元、-15,269.96万元,均为负值。

截至 2020 年 6 月末,公司母公司报表未分配利润为-16,816.80 万元,合并报表中未分配利润为 9,195.90 万元,母公司报表可供股东分配的利润为负值。若公司不能尽快实现盈利,或者控股子公司缺乏现金分红的能力,公司在短期内无法完全弥补累积亏损,存在短期内无法向股东现金分红的风险,将对股东的投资收益造成不利影响。

#### (二) 业绩下滑的风险

2020 年上半年公司归属于母公司股东的净利润为-8,259.42 万元,较上年同期下降 10.17%;扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为-15,269.96 万元,较上年同期下降 29.57%。

公司经营业绩下降主要是 300mm 半导体硅片业务带来亏损增加所致,由于 2020 年上半年新冠肺炎疫情影响,叠加国际贸易和全球科技竞争环境的变化, 半导体行业表现疲软,半导体硅片市场也出现了阶段性调整。公司子公司上海新 昇仍处于"逆周期"投资阶段,产能持续扩张,折旧费用大幅增加,因此公司 300mm 半导体硅片出现较大亏损。

如果后续宏观经济环境持续恶化或半导体行业景气度进一步下降,而上海新昇未能进一步扩大 300mm 半导体产品销售、提高产能利用率并有效降低成本,则公司存在未来业绩下滑幅度继续扩大的风险。

#### (三)技术研发风险

半导体硅片是芯片制造最重要的材料,是半导体产业的基石。同时半导体硅片也是我国半导体产业链与国际先进水平差距最大的环节之一。公司是我国率先实现 300mm 半导体硅片规模化生产的企业,300mm 半导体硅片相关的技术达到了国内领先水平,但与国际前五大硅片制造企业在产品认证数量、适用的技术节点等方面相比仍有一定差距。当前公司正处于奋力追赶国际先进企业的进程之中。

半导体硅片行业属于技术密集型行业,具有研发投入高、研发周期长、研发风险大的特点。随着全球芯片制造技术的不断演进,对半导体硅片的技术指标要求也在不断提高,若公司不能继续保持充足的研发投入,或者在关键技术上未能持续创新,亦或新产品技术指标无法达到预期,将导致公司与国际先进企业的差距再次扩大,对公司的经营业绩造成不利影响。

#### (四)经营风险

#### 1、汇率波动风险

报告期内,公司生产所需的原材料和生产设备主要采购自境外,部分半导体 硅片产品也销往境外,并且公司的进出口业务部分以外币结算。随着公司产销规模的迅速增长,如果未来人民币对美元、欧元、日元等主要币种的汇率波动加大,公司将面临一定的汇率波动风险。

#### 2、原材料价格波动和供应风险

公司半导体硅片产品所用的原材料成本在生产成本中占比较高,其价格波动会对公司的业绩产生一定的影响。同时因为大尺寸半导体硅片对原材料的技术要求较高,目前国内能够供应的合格材料较少,公司的部分原材料依赖进口。公司原材料采购周期为 2-6 个月。若公司主要原材料价格大幅波动或者供应不足,将对公司的生产经营造成不利影响。

#### (五) 宏观环境风险

#### 1、宏观经济及行业波动风险

2020 年上半年,受新冠肺炎疫情影响,公司及境内子公司春节后复工有所延迟,同时因交通运输、人员往来受阻,公司部分原材料运输、机器设备安装进度等受到一定影响。但公司目前生产经营已恢复正常,受影响的设备安装等也将在下半年加快进度,争取完成原定产能扩张计划。公司境外子公司的生产经营暂未因受到疫情影响发生减产或停产、销售发货延迟等情况。

但本次疫情在欧洲、北美等国家和地区的爆发,对全球半导体产业链及终端市场造成了不同程度的影响。公司所处的半导体硅片行业处于半导体产业链的上游,其需求直接受到下游芯片制造及终端应用市场的影响,当宏观经济发生较大波动(如新冠肺炎疫情影响等)时,导致通信、计算机、汽车、消费电子、人工智能等终端市场需求下降,会对公司的业务发展和经营业绩造成不利影响。

#### 2、国际贸易、科技争端加剧风险

近三年来国际局势跌宕起伏,中国面临的国际贸易和科技竞争环境恶化,如 果未来外部环境变动持续或加强,半导体硅片作为产业链上游,其生产经营和对 外销售会受到不利影响。

#### 五、重大违规事项

无。

#### 六、主要财务指标的变动原因及合理性

2020年上半年,公司主要财务数据及指标如下所示:

单位:万元

项目	2020年1-6月/ 2020年6月30日	2019年1-6月/ 2019年6月30日	增减幅度(%)
营业收入	85,427.37	65,446.24	30.53
归属于上市公司股东的净利润	-8,259.42	-7,496.87	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润	-15,269.96	-11,784.85	不适用
经营活动产生的现金流量净额	2,736.44	1,743.83	56.92
归属于上市公司股东的净资产	749,763.60	507,201.00	47.82
总资产	1,175,273.28	996,324.41	17.96
基本每股收益(元/股)	-0.039	-0.043	不适用
稀释每股收益 (元/股)	-0.039	-0.043	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股 收益(元/股)	-0.072	-0.068	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-1.35	-1.76	不适用
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-2.49	-2.76	不适用
研发投入占营业收入的比例(%)	7.58	5.90	增加1.68个百分点

2020年1-6月,公司营业收入为85,427.37万元,较上年同期增长30.53%; 归属于母公司股东净利润为-8,259.42万元,较上年同期亏损增加10.17%;扣除 非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为-15,269.96万元,较上年同期亏损增加29.57%。营业收入较上年同期增长30.53%,主要系2019年3月底并购新 傲科技,因此2019年同期中不包含新傲科技一季度的财务数据;同时子公司上 海新昇300mm硅片的销量持续增加所致。公司利润同比下滑主要是由于一方面 公司持续加大研发投入,同时存货跌价准备计提金额受市场价格影响有所增加所致。

2020 年 1-6 月公司经营活动产生的现金流量净额为 2,736.44 万元,较上年同期略有增加,主要是由于 2019 年 3 月底并购新傲科技,因此 2019 年同期中不包含新傲科技一季度的财务数据所致。

2020年6月30日,公司的资产总额为1,175,273.28万元,较2019年底资产总额996,324.41万元增幅17.96%;归属于上市公司股东的净资产为749,763.60万元,较2019底年股东权益507,201.00万元增幅47.82%。公司总资产和净资产的增长主要是公司上市募集资金增加所致。

#### 七、核心竞争力的变化情况

公司主要从事半导体硅片的研发、生产和销售,是中国大陆规模最大的半导体硅片制造企业之一,也是中国大陆率先实现 300mm 半导体硅片规模化销售的企业。

#### (1) 技术与研发优势

公司主要产品为 300mm 和 200mm 及以下尺寸(含 SOI 硅片)的半导体硅片,经过多年的持续研发和生产实践,公司形成了深厚的技术积累。公司目前掌握了直拉单晶生长、磁场直拉单晶生长、热场模拟和设计、大直径硅锭线切割、高精度滚圆、高效低应力线切割、化学腐蚀、双面研磨、边缘研磨、双面抛光、单面抛光、边缘抛光、硅片清洗、外延、SIMOX、Bonding、Simbond、SmartCut<sup>TM</sup>生产技术等半导体硅片制造的关键技术。

截至 2020 年 6 月末,公司累计承担 7 项国家级重大专项项目,技术水平和科技创新能力国内领先,形成了以单晶生长、抛光、外延生长、SOI 技术、污染控制、表面平整、缺陷控制、热处理体系为代表的核心知识产权体系。公司控股子公司在技术创新方面曾荣获国家科学技术进步一等奖、上海市科学技术进步一等奖、中国科学院杰出科技成就奖等荣誉。

#### (2) 管理团队与人才优势

公司鼓励创新和研发工作,高度重视技术研发团队建设。公司自设立以来持续引进全球半导体硅片行业高端人才,经过多年的积累,公司拥有了一支国际化、专业化的管理和技术研发团队。

#### (3) 客户认证优势

芯片制造企业对各类原材料的质量有着严苛的要求,对供应商的选择非常慎重。进入芯片制造企业的供应商名单具有较高的壁垒。半导体硅片企业的产品进入芯片制造企业的供应链需要经历较长的时间,其对于一个新供应商的认证周期至少需要 9-18 个月。公司部分产品目前已经通过认证并成为台积电、中芯国际、华虹宏力、华力微电子、长江存储、武汉新芯、华润微等知名半导体制造企业的供应商。

#### (4) 产品布局优势

公司半导体硅片产品从尺寸上涵盖 300mm 和 200mm 及以下规格,从制造工艺上包含了抛光片、外延片以及 SOI 硅片等类别,实现了半导体硅片产品较为全面的布局。

#### (5) 全球化布局优势

半导体行业是一个全球化的行业,半导体硅片行业上游原材料供应商、下游芯片制造企业广泛分布于欧洲、亚洲、北美等多个地区。公司子公司 Okmetic 主要生产经营地在欧洲,子公司新傲科技、上海新昇主要生产经营地在中国大陆,公司在欧洲、美洲、亚洲均建立了销售团队。公司将进一步利用全球化布局优势,加强国际合作,进一步开拓国际市场。

如上所述,2020年上半年,公司核心竞争力未发生不利变化。

#### 八、研发支出变化及研发进展

#### (一)研发支出变化情况

公司继续推进国家重大科研项目及公司自研项目的研发工作,2020 年上半年研发支出6,473.13万元,研发投入总额占营业收入比例为7.58%,较上年同期5.90%增加1.68个百分点。

公司研发支出与公司所处的发展阶段、承担的重大研发项目研发进度相一致。 公司研发投入占销售收入的比重高于同行业上市公司平均值,并且公司研发投入 并未受到盈利情况的影响,2020年上半年研发支出仍然保持在较高水平。

#### (二)研发进展

报告期内,公司针对核心技术的研发和产品认证持续展开,针对更先进节点的研发、中试按计划进行,对于已掌握的技术节点也持续进行不同产品的开发。 具体获得的研发和认证成果如下:

截止报告期末,公司 300mm 硅片已获得客户认证的产品规格累计超过 50种,已实现了 28nm 以上所有节点的产品认证以及 64层 3D NAND 产品验证;目前正在认证或研发过程中的产品规格超过 30种,包括应用于 14nm 逻辑芯片、19nm DRAM 芯片及 128层 3D NAND 产品等。

公司 200mm 及以下半导体硅片(含 SOI 硅片)累计已通过认证的产品规格超过 550 种,并有新的产品规格正在开发或认证过程中。

#### 九、新增业务进展是否与前期信息披露一致

不适用。

#### 十、募集资金的使用情况及是否合规

根据中国证券监督管理委员会于2020年3月17日出具的证监许可[2020]430号文《关于同意上海硅产业集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》,上海硅产业集团股份有限公司获准向社会公众公开发行人民币普通股620,068,200股,每股发行价格为人民币3.89元,股款以人民币缴足,募集资金总额计人民币2,412,065,298.00元,扣除发行费用人民币127,675,510.47元(不含增值税)后,募集资金净额共计人民币2,284,389,787.53元,上述募集资金于2020年4月15日到位,业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)予以验证并出具普华永道中天验字(2020)第0303号验资报告。

截至 2020 年 6 月 30 日,公司本年度使用募集资金金额为人民币 143,853.01 万元,累计已使用募集资金金额为人民币 143,853.01 万元,本年度收到募集资金 利息扣除手续费净额为 477.14 万元,累计收到募集资金利息收入扣减手续费净额为 477.14 万元,募集资金余额为人民币 86,658.37 万元,其中用于现金管理金额为 70,090.00 万元。

截至 2020 年 6 月 30 日,公司募集资金专户余额为人民币 16,568.37 万元(含募集资金利息收入扣减手续费净额),具体情况如下:

项目	金额(万元)
实际收到的募集资金金额	230,034.24
减: 本年度直接投入募投项目	83,960.96
置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金	58,296.79
置换以自筹资金预先支付的发行费用	1,449.52
本年度支付发行费用及增值税税金	145.74
加:募集资金利息收入扣减手续费净额	477.14
减: 用于现金管理金额	70,090.00
募集资金专户期末余额	16,568.37

公司 2020 年上半年募集资金存放与使用情况符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则(2019 年 4 月修订)》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等法律法规的规定,对募集资金进行了专户存储和专项使用,并及时履行了相关信息披露义务,募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。

### 十一、控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员的持股、质 押、冻结及减持情况

公司无控股股东和实际控制人。公司前两大股东上海国盛(集团)有限公司和国家集成电路产业投资基金股份有限公司分别持有公司 567,000,000 股股份,持股比例均为 22.86%。2020 年上半年,公司上述股东持股数未发生增减变动。截至 2020 年 6 月 30 日,上述股东持有的公司股份均不存在质押、冻结及减持的情形。

公司董事、监事、高级管理人员未直接或间接持有公司股份。

# 十二、上海证券交易所或保荐机构认为应当发表意见的其他事项 无。

(以下无正文)

(本页无正文,为《海通证券股份有限公司关于上海硅产业集团股份有限公司 2020年半年度持续督导跟踪报告》之签字盖章页)

保荐代表人签名:

张博文

张博文

曹岳承

